

比表面積及孔隙分佈分析儀使用辦法暨申請表

一、樣品準備及說明

樣品前處理：經過事先高溫處理過之樣品(處理溫度 $>500^{\circ}\text{C}$)，需先在 100°C 烘箱內烘一天去除吸附之水氣。未經過高溫處理之樣品(樣品內或結構上含有界面活性劑、改質劑、或其他有機物者)，請附上 TGA 熱分析圖，避免在樣品前處理之除氣階段造成有機物裂解、揮發導致系統污染。

二、自行操作機台訓練及檢定

1. 訓練方式由負責技士親自訓練。
2. 上機考試：由負責技士檢定使用操作情形，通過者即具有使用執照。

三、相關使用規定

1. 預約使用必須為本人到場，若有責任歸屬是以該時段預約者之責任。
2. 操作機台時必須詳實填寫使用紀錄表，若機台發生異狀須詳實填寫狀況、初步應變措施並通知技士處理。
3. 使用者必須遵守操作規範，非關正常操作機台的一切行為一概禁止，如有不當使用造成損壞，需負修理賠償責任。

使用者姓名：_____ 申請日期：____年__月__日

聯絡電話及電子信箱：_____ 指導教授簽名：_____

使用方式：自行操作(限環工所，每4小時150元，不足4小時以4小時計費)

委託操作

比表面積分析 (環工所委託操作 1,000 元/件，外系委託操作 1,200 元/件)

中孔分析 (環工所委託操作 2,000 元/件，外系委託操作 2,400 元/件)

微孔分析 (環工所委託操作 3,000 元/件，委託操作 3,600 元/件)

樣品敘述：(表格不足處,請再自行增加)

樣品件數	樣品 1	樣品 2	樣品 3	樣品 4	樣品 5
樣品說明 (成分、製造程序)					
熔點 (或熱裂解溫度)					
預估比表面積					
除氣溫度					
升溫速率					
除氣時間					

預估金額: